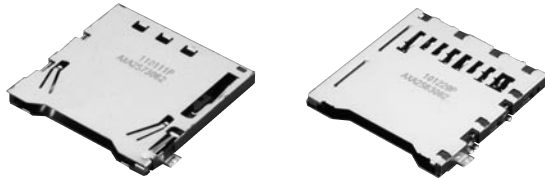


Connect To The Next

両面金属シェルと溶接工法により堅牢性と耐EMI性を更に強化(SDXCカード対応、逆挿入防止機能付き)

SDメモリカード用ソケット Sタイプ(SDIO対応)

RoHS対応



標準タイプ

リバースタイプ

特長

- 両面金属シェル構造で「堅牢性」「耐EMI性」「端子平坦度」に優れます。
- 高信頼の検知SW構造採用。
- カード飛び出し防止機能あり/なし対応。
- カード無理抜き防止ロック構造。
- SDIO規格に準拠(グラウンドタブ付き)。

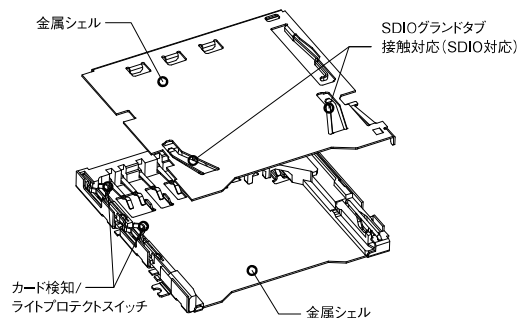
用途

- DSC・DVC・PDA・ハンディターミナル・ノートPC・ゲーム機・携帯オーディオなどSDカードを使用する機器でご利用いただけます

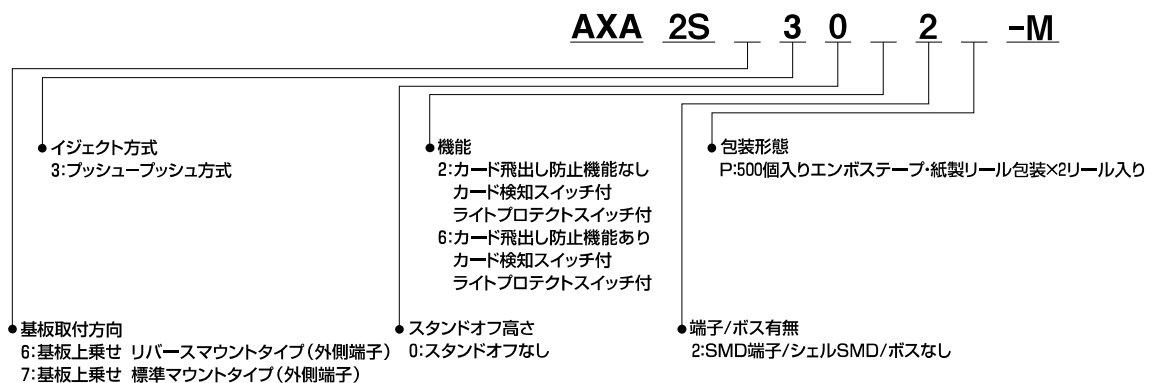
詳細特長

■両面金属シェル構造で「堅牢性」「耐EMI性」「端子平坦度」に優れる。

上下の金属シェルを溶接接合した構造で、堅牢性とシールド性を確保。実装時にアースパターンを設けることでEMI対策に有効です。リフロー熱による影響を受けにくい構造のため、リフロー後での良好な端子平坦度を保ちます。



ご注文品番体系



SDメモリーカード用ソケットSタイプ(SDIO対応)(AXA2S)

品 種

品名	イジェクト方式	カード検知スイッチ	カード飛び出し防止機能	取付タイプ	ご注文品番	箱入数	
						内箱	外箱
SDメモリーカード用ソケットSタイプ	プッシュープッシュ	あり	あり	標準マウントタイプ	AXA2S73062*-M	品番末尾*印 P:500個(1リール) (エンボス包装)	品番末尾*印 P:1,000個(2リール) (エンボス包装)
				リバースマウントタイプ	AXA2S63062*-M		
			なし	標準マウントタイプ	AXA2S73022*-M		
				リバースマウントタイプ	AXA2S63022*-M		

定 格

性能概要

項目	性能	試験条件	
電気的特性	定格電流	0.5A/1ピン	
	接触抵抗	信号コンタクト部: 100mΩ以下(初期) 検知コンタクト部: 150mΩ以下(初期)(カード検知・ライトプロテクト検知)	JIS C 5402の測定方法でHP4338Bで測定する
	絶縁抵抗	1,000MΩ以上(初期)	DC500Vメガーにて1分間で測定
	耐電圧	AC500Vにて1分間	規格電圧を1分間印加し、検知電流1mAにて短絡、損傷のないこと
機械的特性	耐振動性	周波数: 10Hz~2,000Hz 加速度: 20.0m/s ² {2.0G} 0.1μs以上の電流遮断なきこと	
	カード挿入力	40N以下	
	カード抜去力	1N以上 40N以下	
寿命特性	カード挿抜寿命	機械的寿命: 10,000回 試験後接触抵抗: 信号コンタクト部: 変化量が40mΩ以下 検知コンタクト部: 150mΩ以下(カード検知・ライトプロテクト検知)	繰り返し挿抜頻度 600回/時間以下
環境的特性	使用周囲温度	-25℃~90℃	低温において氷結しないこと。結露しないこと。
	保存温度	-40℃~90℃、 弊社包装形態での保証温度は-40℃~50℃	低温において氷結しないこと。結露しないこと。
	はんだ耐熱性	リフローはんだ ピーク温度: 250℃以下 手はんだ付け 全て先温度: 300℃ 5秒以下	赤外線リフローはんだ装置にてはんだ付を行うコネクタ(シエル)の表面温度
	耐湿度性(嵌合状態)	接触抵抗: 信号コンタクト部: 変化量が40mΩ以下 検知コンタクト部: 150mΩ以下(カード検知・ライトプロテクト検知) 絶縁抵抗: 100MΩ以上	MIL-STD-1344A, METHOD1002 温度 40±2℃ 湿度 90~95%R.H 試験条件 500時間
適合メモリーカード	SDメモリーカード※1		
質量(重量)	2.9g		

注)※1.規格外のカードを使用した場合、性能概要に示す内容については保証できませんのでご注意ください。

材質・表面処理

部品名	材質	表面処理
信号コンタクト	銅合金	接触部: Ni下地 PdNiめっき+Auフラッシュめっき はんだ付け部: Ni下地 Auめっき
検知コンタクト		接触部: Ni下地 Auめっき はんだ付け部: Ni下地 Auめっき
保持金具	ステンレス	はんだ付け部: Niストライク Auめっき(部分めっき)

寸法図

単位：mm

■ 基板上乗せ 標準マウントタイプ(スタンドオフなし)

ご注文品番

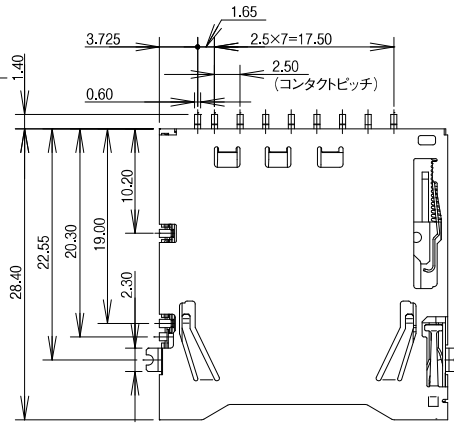
AXA2S73062*-M(カード飛び出し防止あり)

AXA2S73022*-M(カード飛び出し防止なし)

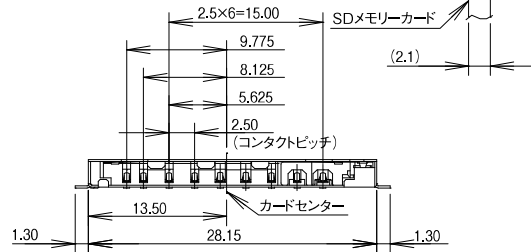
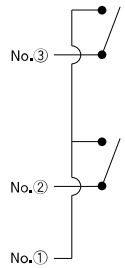
※1
0.08(スタンドオフ寸法)
2.70
(信号・検知コンタクト・保持金具)
端子平坦度
0.10



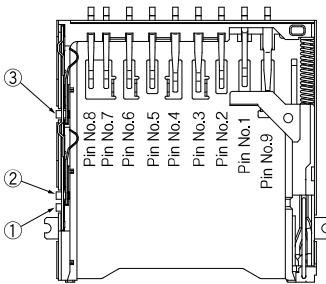
外形寸法図



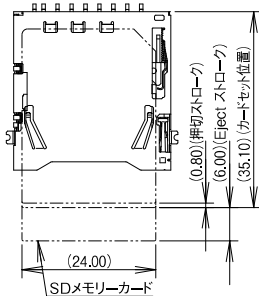
回路図



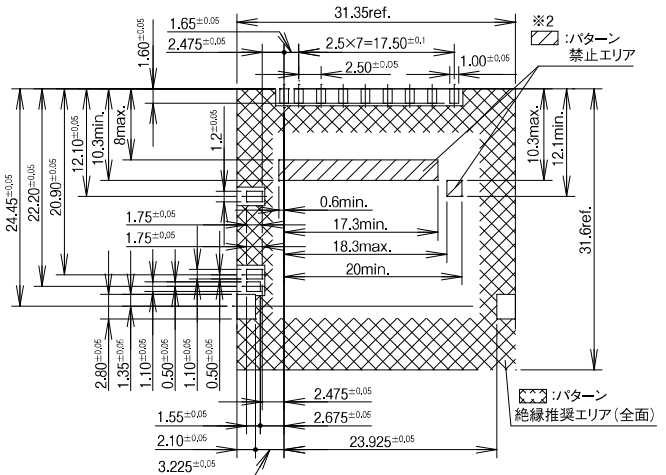
内部詳細図



カードセット状態図



プリント基板推奨加工図(TOP VIEW)



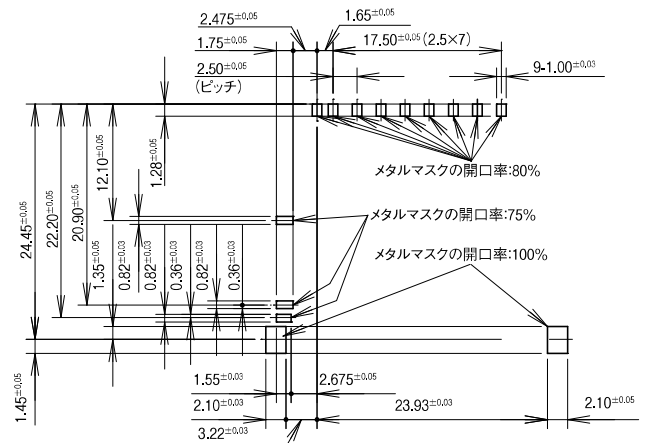
カード検知・書き込み防止検知スイッチによるコンタクト状態一覧表

カード挿入有無	書き込み防止スイッチ		カード検知スイッチ
	書き込み不可	書き込み可	
未挿入時	オープン	オープン	オープン
挿入時	オープン	クローズ	クローズ
部品番号	①-②		①-③

注) ※1. スタンドオフ寸法は、プリント基板表面からソケット下面までの寸法を確保するために、プリント基板のレジスト厚み・シルク印刷などの厚みを考慮した寸法になっています。

※2. この軸距については、信号コンタクト先端が基板面に接触する恐れがあるため、パターン禁止エリアとしています。

メタルマスク開口部推奨加工図
メタルマスク厚さ：120 μmの場合



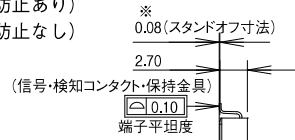
SDメモリーカード用ソケットSタイプ(SDIO対応)(AXA2S)

■ 基板上乗せ リバースマウントタイプ(スタンドオフなし)

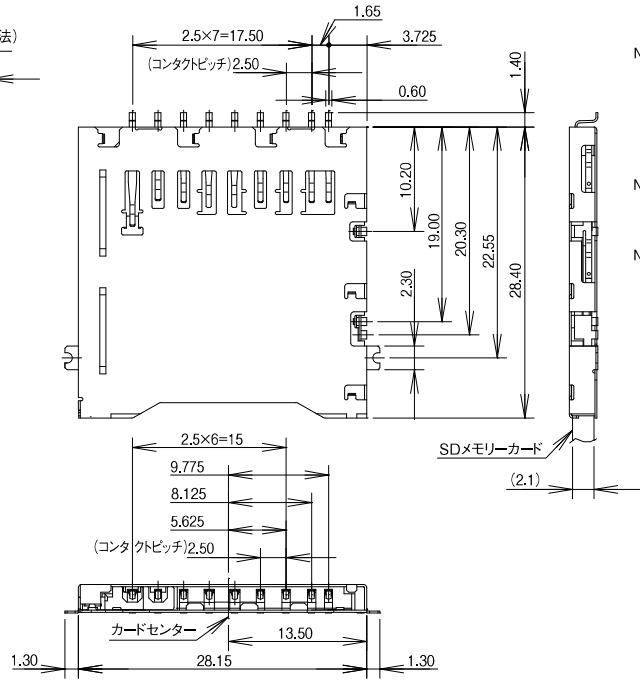
ご注文品番

AXA2S63062 * -M(カード飛び出し防止あり)

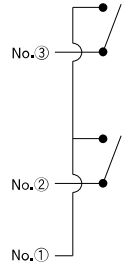
AXA2S63022 * -M(カード飛び出し防止なし)



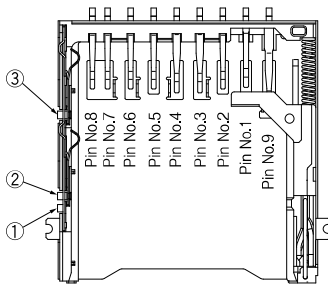
外形寸法図



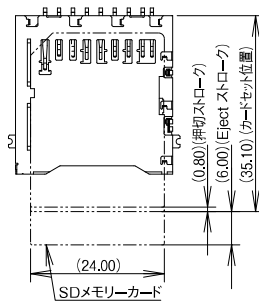
回路図



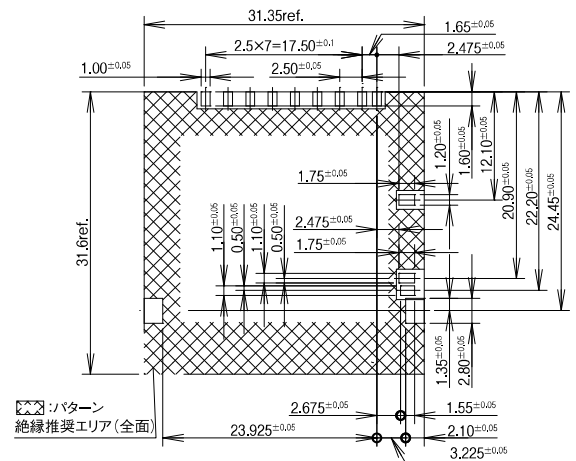
内部詳細図



カードセット状態図



プリント基板推奨加工図(TOP VIEW)

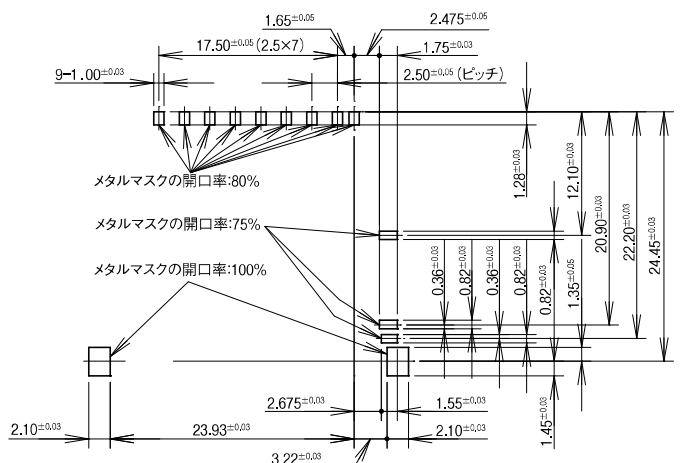


カード検知・書き込み防止検知スイッチによるコンタクト状態一覧表

カード挿入 有無	書き込み防止スイッチ		カード検知スイッチ
	書き込み不可	書き込み可	
未挿入時	オープン	オープン	オープン
挿入時	オープン	クローズ	クローズ
部品番号	①-②		①-③

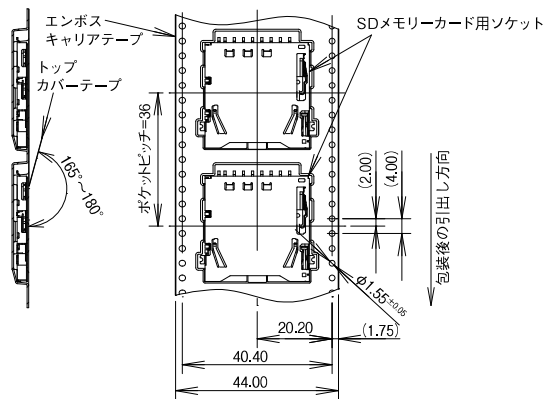
注) *スタンドオフ寸法は、プリント基板表面からソケット下面までの寸法を確保するために、プリント基板のレジスト厚み・シルク印刷などの厚みを考慮した寸法になっています。

メタルマスク開口部推奨加工図
メタルマスク厚さ：120 μmの場合

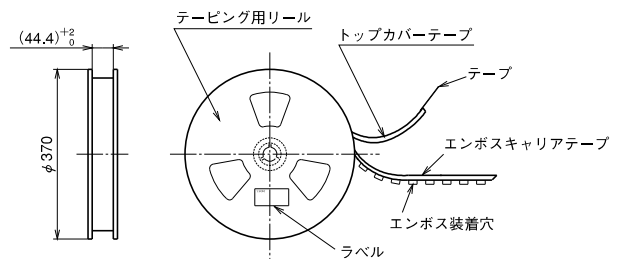


エンボステープ寸法図

■ テーピング仕様



■ プラスチック製リール仕様(JIS C 0806-1)



使用上のご注意

■ プリント基板の設計において

端子はんだ付け部の機械的強度確保のために、推奨フットパターンでの設計を行ってください。

■ ソケットの実装時において

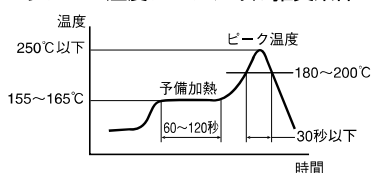
1) リフローはんだの際、スライダ(摺動部分)がロック状態になっていると、熱によりスライダが変形し、動作しなくなりますので、はんだ付けを行う前にカードの挿抜を行った場合は、スライダのロックが解除されていることを確認のうえ、実装願います。
2) P/C板への実装の際に、接触部、端子部に不要な外力が加わり、変形などが生じないようにご注意ください。

■ はんだ付け時において

1) リフローはんだ

- ・クリームはんだの印刷は、スクリーン印刷方式をお勧めいたします。
- ・クリームはんだの印刷は推奨フットパターンにてスクリーン厚さ0.12mmで行ってください。
- ・CoMコンタクト(1ヶ所)、Noコンタクト(2ヶ所)についてのメタルマスク開口率は75%で行ってください。
- ・推奨スクリーン印刷厚さ以外でお使いの際は、ご相談ください。
- ・リフロー温度プロファイル推奨条件を下図に示します。

リフロー温度プロファイル推奨条件



- ・温度はプリント基板表面で測定し設定してください。
- ・ソケットのリフロー後、裏面のリフローはんだを行う場合、ソケットが落下する恐れがありますので、テープ、接着剤などでの固定を行ってください。2回リフローはんだは可能です。
- 2) 手はんだ
 - ・はんだこて先温度300℃、5秒以下ではんだ付け作業を行ってください。
 - ・スタンドオフ0mmタイプでは、長い時間はんだ付け作業を行った後、はんだ量が多すぎると保持金具部にてはんだ這い上がりが発生する恐れがありますので、ご注意ください。

■ はんだ付け後洗浄において

本品は内部に摺動部およびカード検知コンタクト・ライトプロテクトがあり、洗浄後フラックスなどの残渣が内部に残ると、カードの挿抜が困難となったり、コンタクトが接触不良となるため、洗浄は行わないでください。(プリント板、はんだ端子部の部分的な洗浄は可能です。)

■ P/C板実装後において

1) P/C板ソリはソケット全長に対して、0.03mm以下となるよう、管理ください。
2) P/C板組立、ブロック仕掛状態の保管において、積み上げられソケットに過大な荷重が作用しないようにしてください。
3) P/C板組立、ブロック仕掛状態での移送時にソケットに外力が作用しないようにしてください。

■ 単品状態での取り扱いにおいて

1) 作業機などより床面に落下させることのないように取り扱いください。
2) 端子に過度の力が加わると変形して、端子平坦度が損なわれますので、取り扱いにはご注意ください。
3) 端子の繰り返し折曲げは折損となりますのでご注意ください。

■ カード嵌合において

1) 本品は、小型、軽量化をするために、一部成形品の肉厚を薄くしておりますので、使用時に過度なこじり挿抜が行われないような状態になるよう、筐体の設計にご配慮願います。
2) 本品はカードの逆挿入防止構造を採用しておりますので、誤ってカードを逆挿入し続けるとソケットおよびカードの破損の原因となりますのでご注意ください。
3) はんだ付けされていない状態で、ソケットのカード挿抜を行うと、接合部の固定力低下や平坦度不良の原因となりますのでご注意ください。
4) カード嵌合状態から無理にカードを引き抜くとカード抜け防止のロック力が低下しますので、カードを抜去する時は、必ずカードを挿入方向に押し込んで、ロックを解除してから、カードを引き抜いてください。
5) 取り扱い説明書などに下記内容の注意を喚起いただきますよう、ご配慮願います。
6) MMCに対しては、カード抜け防止のロックは効きません。
7) MMCに対しては、逆挿入防止構造を設けておりませんので、挿入方向についてはご注意ください。
8) MMCを挿入すると、MMCのNo.7の接触部にソケットのNo.7、8の信号コンタクトがショートする可能性があります。

■ 筐体の設計において

1) 埃などの接触部への侵入は接触不良の原因になりますので、カバーを設けるなど筐体の設計にご配慮願います。
2) カードの挿抜をスムーズにするため、ソケット上面の金属シェルに力が加わらないよう筐体の設計にご配慮願います。金属シェルを押し付けるような力が加わった場合、カードが押えられ、イジェクトされない場合があります。
3) カード挿抜する際に過大な力が、ソケット本体に加わらないように、ガイドなどにより保持を行ってください。

■ カードの飛び出しにおいて

1) 本ソケットは決められた条件下でカード飛び出し防止機能を有しておりますが、誤った使用による事故を未然に防ぐためにも使用者に注意を促すことは、製造物責任の観点から強くお勧めいたします。
2) 本ソケットの機構上、(1)カードの不完全な挿入状態、(2)カードの逆挿入状態、(3)カードの逆挿入後の飛び出し防止寿命を保証するものではありません。
3) 本ソケットはカード飛び出しを防止するために、挿抜時にあえてカードに抵抗を加えています。そのため、通常カード挿入時、引き抜き時に抵抗を感じますが、ご了承ください。

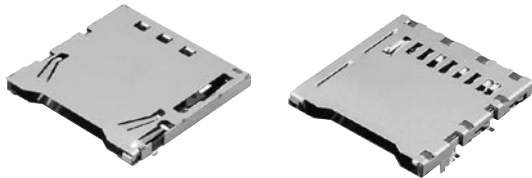
■ その他

はんだ付け後P/C板の絶縁劣化を防止するためにコーティングする際には、ソケットにコーティング剤が付着しない方法で行ってください。

両面金属シェルと溶接工法により堅牢性と耐EMI性を更に強化(SDHCカード対応、逆挿入防止機能付き)

SDメモリカード用ソケット Rタイプ(SDIO対応)

RoHS対応



標準タイプ

リバースタイプ

特長

- 両面金属シェル構造で「堅牢性」「耐EMI性」「端子平坦度」に優れます。
- 高信頼の検知SW構造採用。
- カード飛び出し防止機能あり/なし対応。
- カード無理抜き防止ロック構造。
- SDIO規格に準拠(グラウンドタブ付き)。

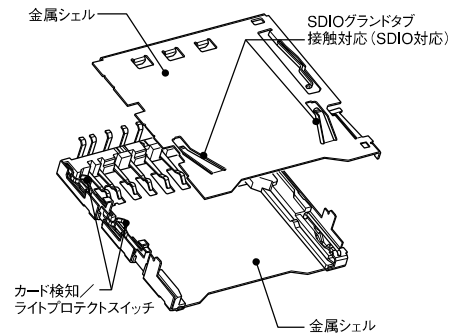
用途

- DSC・DVC・PDA・ハンディターミナル・ノートPC・ゲーム機・カーナビ・携帯オーディオなどSDカードを使用する機器でご利用いただけます

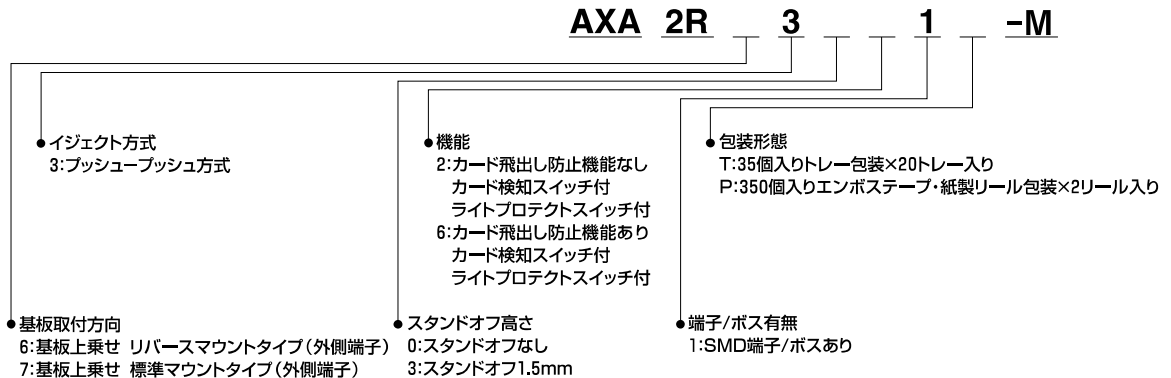
詳細特長

■両面金属シェル構造で「堅牢性」「耐EMI性」「端子平坦度」に優れる。

上下の金属シェルを溶接接合した構造で、堅牢性とシールド性を確保。実装時にアースパターンを設けることでEMI対策に有効です。リフロー熱による影響を受けにくい構造のため、リフロー後での良好な端子平坦度を保ちます。



ご注文品番体系



品 種

品名	イジェクト方式	カード検知スイッチ	カード飛び出し防止機能	取付タイプ	スタンドオフ高さ (mm)	ご注文品番	箱入数	
							内箱	外箱
SDメモリーカード用ソケットRタイプ(SDIO対応)	プッシュアッププッシュ	あり	あり	標準マウントタイプ	0	AXA2R73061*-M	品番末尾*印 P:350個(1リール) (エンボス包装) T:35個(1トレイ) (トレイ包装)	品番末尾*印 P:700個(2リール) (エンボス包装) T:700個(20トレイ) (トレイ包装)
					1.5	AXA2R73361*-M		
				リバースマウントタイプ	0	AXA2R63061*-M		
					1.5	AXA2R63361*-M		
			なし	標準マウントタイプ	0	AXA2R73021*-M		
					1.5	AXA2R73321*-M		
				リバースマウントタイプ	0	AXA2R63021*-M		
					1.5	AXA2R63321*-M		

定 格

性能概要

項目		性能	試験条件
電気的特性	定格電流	0.5A/1ピン	
	接触抵抗	信号コンタクト部：100mΩ以下(初期) 検知コンタクト部：150mΩ以下(初期)(カード検知・ライトプロテクト検知)	JIS C 5402の測定方法でHP4338Bで測定する
	絶縁抵抗	1,000MΩ以上(初期)	DC500Vメガーにて1分間で測定
	耐電圧	AC500Vにて1分間	規格電圧を1分間印加し、検知電流1mAにて短絡、損傷のないこと
機械的特性	耐振動性	周波数：10Hz～55Hz 加速度：20.0m/s ² (2.0G) 0.1μs以上の電流遮断なきこと	
	カード挿入力	40N以下	
	カード抜去力	1N以上 40N以下	
寿命特性	カード挿抜寿命	機械的寿命：10,000回 試験後接触抵抗：信号コンタクト部：100mΩ以下 検知コンタクト部：150mΩ以下(カード検知・ライトプロテクト検知)	繰り返し挿抜頻度 600回/時間以下
環境的特性	使用周囲温度	-25℃～90℃	低温において氷結しないこと。結露しないこと。
	保存温度	-40℃～90℃、 弊社包装形態での保証温度は-40℃～50℃	低温において氷結しないこと。結露しないこと。
	はんだ耐熱性	リフローはんだ ピーク温度：250℃以下 手はんだ付け 初て先温度：300℃ 5秒以下	赤外線リフローはんだ装置にてはんだ付を行うコネクタ(シエル)の表面温度
	耐湿度性(嵌合状態)	接触抵抗：信号コンタクト部：100mΩ以下 検知コンタクト部：150mΩ以下(カード検知・ライトプロテクト検知) 絶縁抵抗：100MΩ以上	MIL-STD-1344A, METHOD1002 温度 40±2℃ 湿度 90～95%R.H 試験条件 500時間
適合メモリーカード		SDメモリーカード※1	
質量(重量)		2.9g	

注)※1.規格外のカードを使用した場合、性能概要に示す内容については保証できませんのでご注意ください。

材質・表面処理

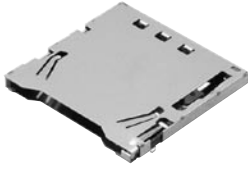
部品名	材質	表面処理
信号コンタクト	銅合金	接触部：Ni下地 PdNiめっき+Auフラッシュめっき はんだ付け部：Ni下地 Auめっき
検知コンタクト		接触部：Ni下地 Auめっき はんだ付け部：Ni下地 Auめっき
保持金具	ステンレス	はんだ付け部：Niストライク Auめっき(部分めっき)

■ 基板上乗せ 標準マウントタイプ(スタンドオフなし)

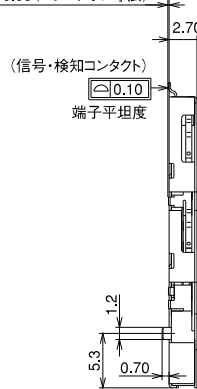
ご注文品番

AXA2R73061 * -M (カード飛び出し防止あり)

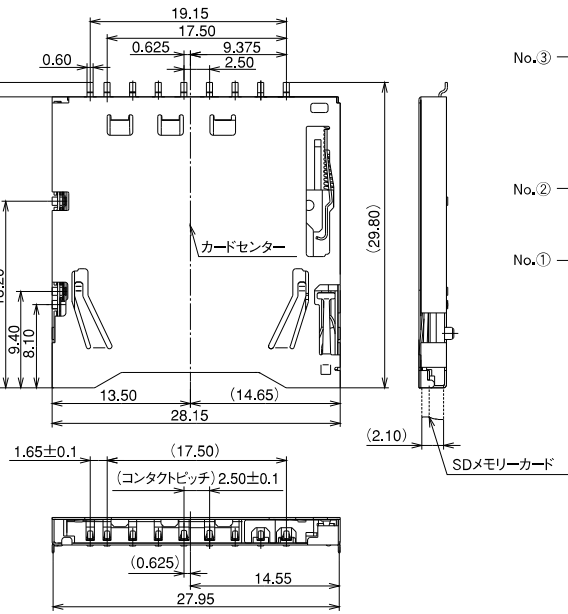
AXA2R73021 * -M (カード飛び出し防止なし)



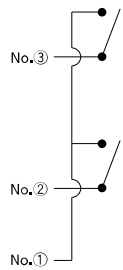
※1 0.08 (スタンドオフ寸法)



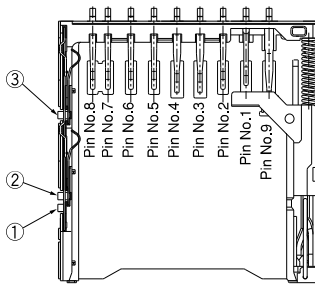
外形寸法図



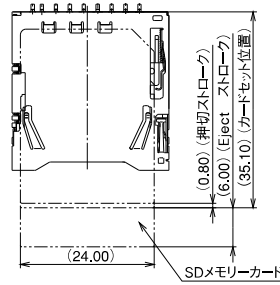
回路図



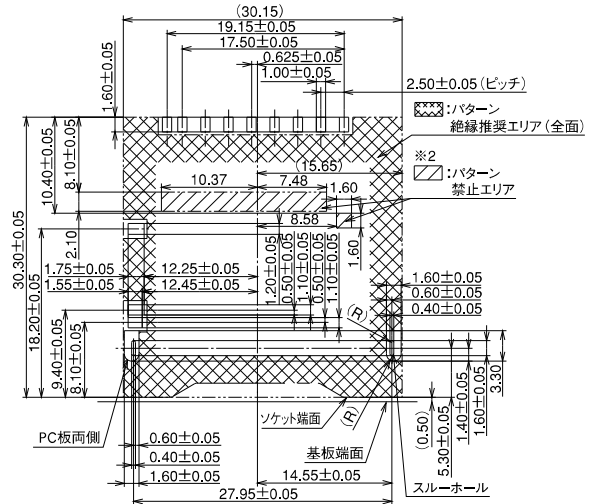
内部詳細図



カードセット状態図



プリント基板推奨加工図 (TOP VIEW)



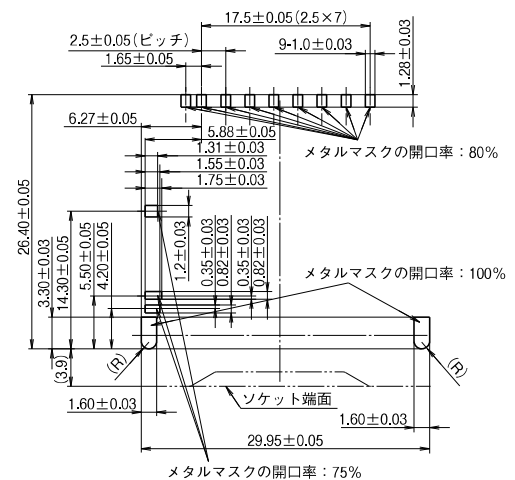
カード検知・書き込み防止検知スイッチによるコンタクト状態一覧表

カード挿入 有無	書き込み防止スイッチ		カード検知スイッチ
	書き込み不可	書き込み可	
未挿入時	オープン	オープン	オープン
挿入時	オープン	クローズ	クローズ
部品番号	①-②		①-③

注) ※1. スタンドオフ寸法は、プリント基板表面からソケット下面までの寸法を確保するために、プリント基板のレジスト厚み・シルク印刷などの厚みを考慮した寸法になっています。

※2. この範囲については、信号コンタクト先端が基板面に接触する恐れがあるため、パターン禁止エリアとしています。

メタルマスク開口部推奨加工図
メタルマスク厚さ：120 μmの場合



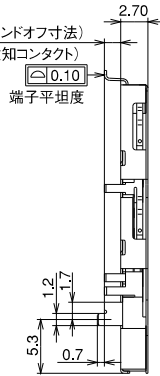
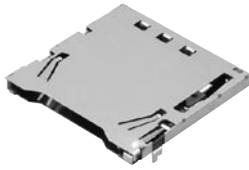
SDメモリーカード用ソケットRタイプ(SDIO対応)(AXA2R)

■ 基板上乗せ 標準マウントタイプ(スタンド1.5mm)

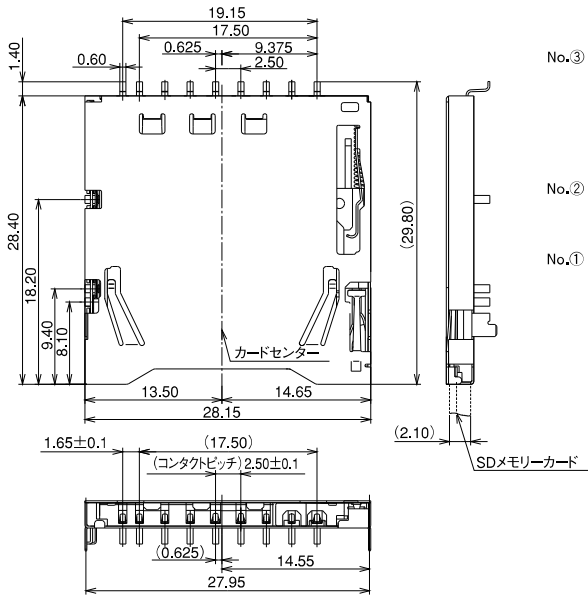
ご注文品番

AXA2R73361 * -M(カード飛び出し防止あり)

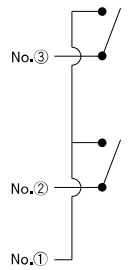
AXA2R73321 * -M(カード飛び出し防止なし) ※ 1.58(スタンドオフ寸法)
(信号・検知コンタクト)



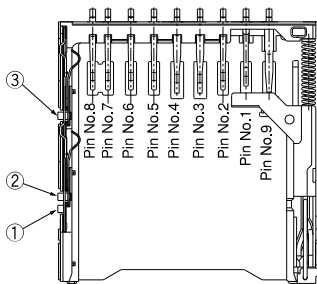
外形寸法図



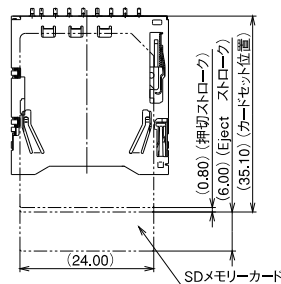
回路図



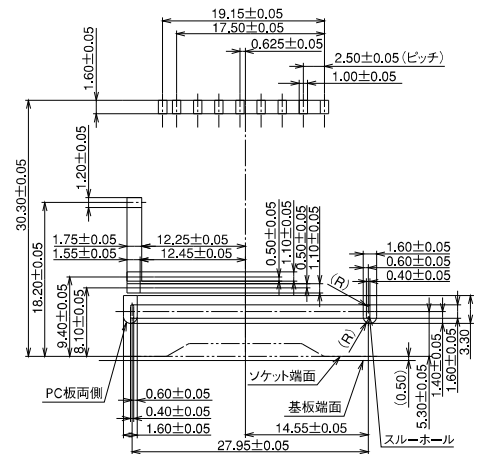
内部詳細図



カードセット状態図



プリント基板推奨加工図(TOP VIEW)

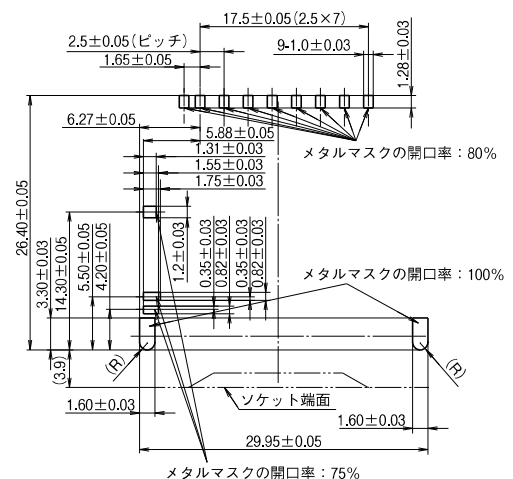


カード検知・書き込み防止検知スイッチによるコンタクト状態一覧表

カード挿入 有無	書き込み防止スイッチ		カード検知スイッチ
	書き込み不可	書き込み可	
未挿入時	オープン	オープン	オープン
挿入時	オープン	クローズ	クローズ
部品番号	①-②		①-③

注) ※スタンドオフ寸法は、プリント基板表面からソケット下面までの寸法を確保するために、プリント基板のレジスト厚み・シルク印刷などの厚みを考慮した寸法になっています。

メタルマスク開口部推奨加工図
メタルマスク厚さ：120 μmの場合



SDメモリーカード用ソケットRタイプ(SDIO対応)(AXA2R)

■ 基板上乗せ リバースマウントタイプ(スタンドオフなし)

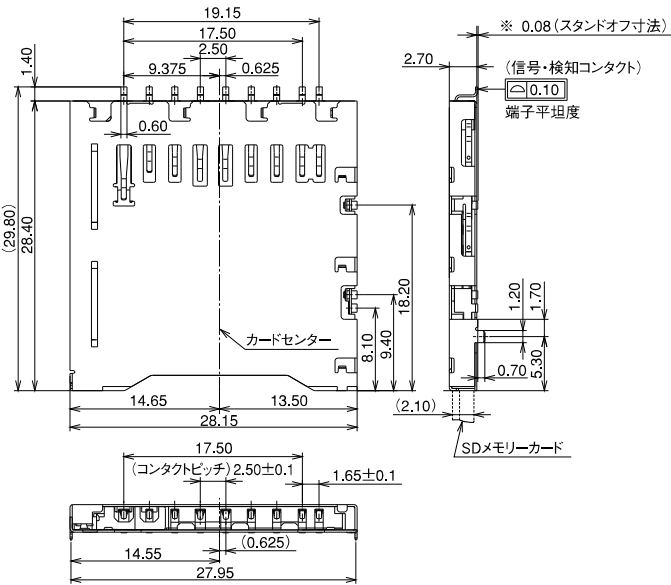
ご注文品番

AXA2R63061 * -M(カード飛び出し防止あり)

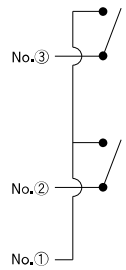
AXA2R63021 * -M(カード飛び出し防止なし)



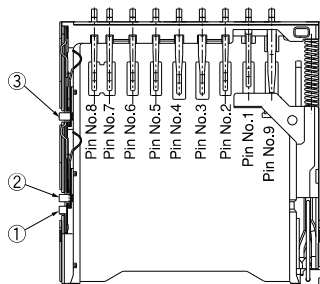
外形寸法図



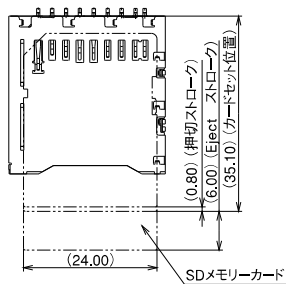
回路図



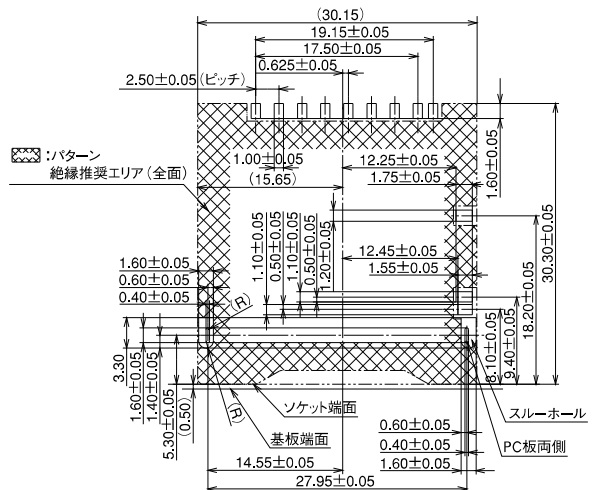
内部詳細図



カードセット状態図



プリント基板推奨加工図(TOP VIEW)

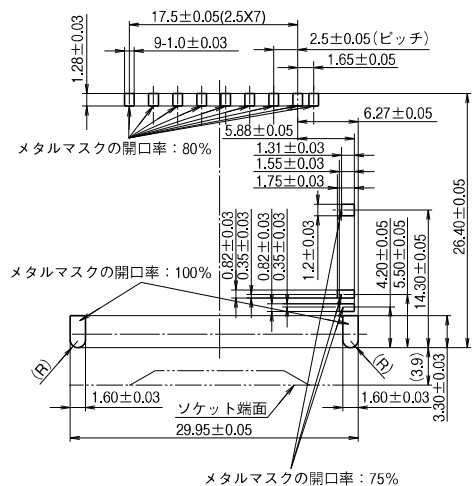


カード検知・書き込み防止検知スイッチによるコンタクト状態一覧表

カード挿入有無	書き込み防止スイッチ		カード検知スイッチ
	書き込み不可	書き込み可	
未挿入時	オープン	オープン	オープン
挿入時	オープン	クローズ	クローズ
部品番号	①-②		①-③

注) *スタンドオフ寸法は、プリント基板表面からソケット下面までの寸法を確保するために、プリント基板のレジスト厚み・シルク印刷などの厚みを考慮した寸法になっています。

メタルマスク開口部推奨加工図
メタルマスク厚さ：120 μmの場合



■ 基板上乗せ リバースマウントタイプ(スタンドオフ1.5mm)

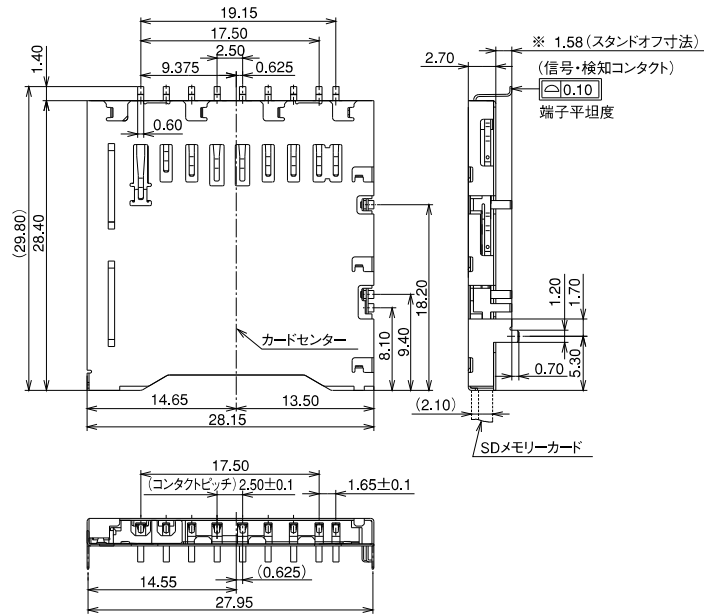
ご注文品番

AXA2R63361 * -M(カード飛び出し防止あり)

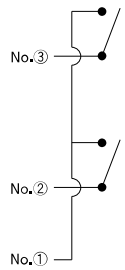
AXA2R63321 * -M(カード飛び出し防止なし)



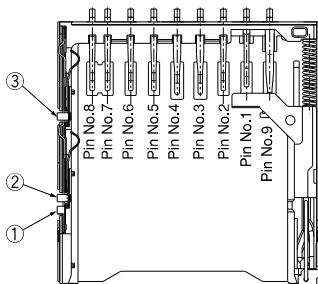
外形寸法図



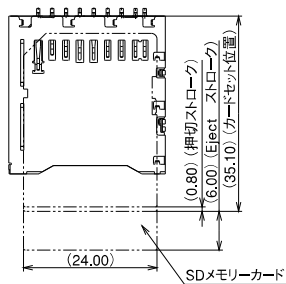
回路図



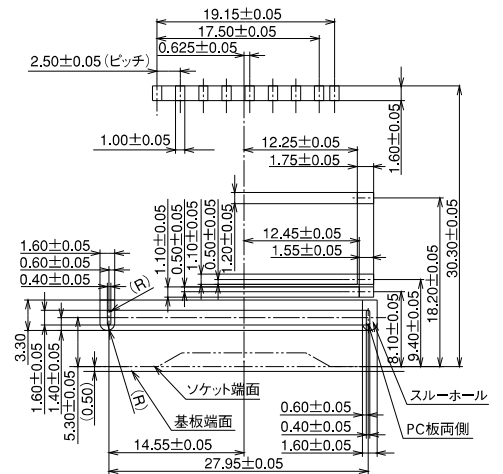
内部詳細図



カードセット状態図



プリント基板推奨加工図(TOP VIEW)

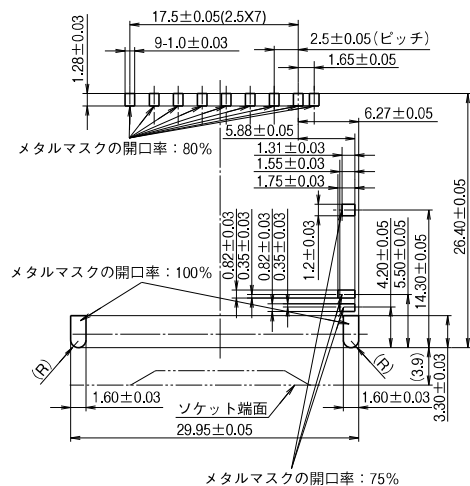


カード検知・書き込み防止検知スイッチによるコンタクト状態一覧表

カード挿入有無	書き込み防止スイッチ		カード検知スイッチ
	書き込み不可	書き込み可	
未挿入時	オープン	オープン	オープン
挿入時	オープン	クローズ	クローズ
部品番号	①-②		①-③

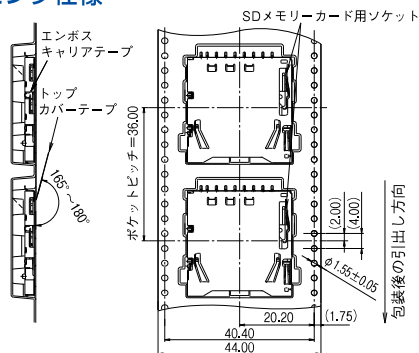
注) *スタンドオフ寸法は、プリント基板表面からソケット下面までの寸法を確保するために、プリント基板のレジスト厚み・シルク印刷などの厚みを考慮した寸法になっています。

メタルマスク開口部推奨加工図
メタルマスク厚さ：120 μmの場合

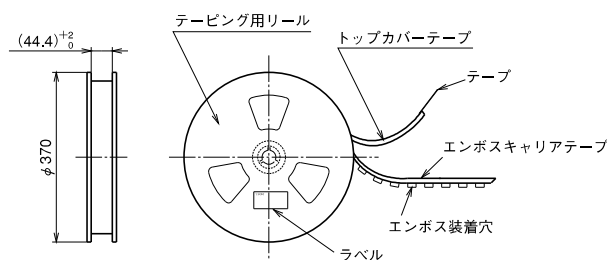


エンボステープ寸法図

■ テーピング仕様



■ プラスチック製リール仕様(JIS C0806-1995)



使用上のご注意

■ プリント基板の設計において

端子はんだ付け部の機械的強度確保のために、推奨フットパターンでの設計を行ってください。

■ ソケットの実装時において

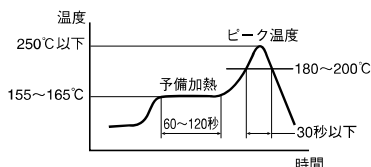
- 1)リフローはんだの際、スライダ(摺動部分)がロック状態になっていると、熱によりスライダが変形し、動作しなくなりますので、はんだ付けを行う前にカードの挿抜を行った場合は、スライダのロックが解除されていることをご確認のうえ、実装願います。
- 2)P/C板への実装の際に、接触部、端子部に不要な外力が加わり、変形などが生じないようにご注意ください。
- 3)トレー包装での自動実装をされる場合は、トレー現物をご確認の上でご検討ください。

■ はんだ付け時において

1)リフローはんだ

- ・クリームはんだの印刷は、スクリーン印刷方式をお薦めいたします。
- ・クリームはんだの印刷は推奨フットパターンにてスクリーン厚さ0.12mmで行ってください。
- ・CoMコンタクト(1ヶ所)、Noコンタクト(2ヶ所)についてのメタルマスク開口率は75%で行ってください。
- ・推奨スクリーン印刷厚さ以外でお使いの際は、ご相談ください。
- ・リフロー温度プロファイル推奨条件を下記に示します。

リフロー温度プロファイル推奨条件



- ・温度はプリント基板表面で測定し設定してください。
- ・ソケットのリフロー後、裏面のリフローはんだを行う場合、ソケットが落下する恐れがありますので、テープ、接着剤などでの固定を行ってください。2回リフローはんだは可能です。

2)手はんだ

- ・はんだこて先温度300°C、5秒以下ではんだ付け作業を行ってください。
- ・スタンドオフ0mmタイプでは、長い時間はんだ付け作業を行った後、はんだ量が多すぎると保持金具部にてはんだ這い上がりが発生する恐れがありますので、ご注意ください。

■ はんだ付け後洗浄において

本品は内部に摺動部およびカード検知コンタクト・ライトプロテクトがあり、洗浄後フラックスなどの残渣が内部に残ると、カードの挿抜が困難となったり、コンタクトが接触不良となるため、洗浄は行わないでください。(プリント板、はんだ端子部の部分的な洗浄は可能です。)

■ P/C板実装後において

- 1)P/C板ソリはソケット全長に対して、0.03mm以下となるよう、管理ください。
- 2)P/C板組立、ブロック仕掛状態の保管において、積み上げられソケットに過大な荷重が作用しないようにしてください。
- 3)P/C板組立、ブロック仕掛状態での移送時にソケットに外力が作用しないようにしてください。

■ 単品状態での取り扱いにおいて

- 1)作業機などより床面に落下させることのないように取り扱いください。
- 2)端子に過度の力が加わると変形して、端子平坦度が損なわれますので、取り扱いにはご注意ください。
- 3)端子の繰り返しの折り返しは折損となりますのでご注意ください。

■ カード嵌合において

- 1)本品は、小型、軽量化をするために、一部成形品の肉厚を薄くしておりますので、使用時に過度なこじり挿抜が行われないような状態になるよう、筐体の設計にご配慮願います。
- 2)本品はカードの逆挿入防止構造を採用しておりますので、誤ってカードを逆挿入し続けるとソケットおよびカードの破損の原因となりますのでご注意ください。
- 3)はんだ付けされていない状態で、ソケットのカード挿抜を行うと、接合部の固定力低下や平坦度不良の原因となりますのでご注意ください。
- 4)カード嵌合状態から無理にカードを引き抜くとカード抜け防止のロック力が低下しますので、カードを抜去する時は、必ずカードを挿入方向に押し込んで、ロックを解除してから、カードを引き抜いてください。
- 5)取り扱い説明書などに下記内容の注意を喚起いただきますよう、ご配慮願います。
- 6)MMCに対しては、カード抜け防止のロックは効きません。
- 7)MMCに対しては、逆挿入防止構造を設けておりませんので、挿入方向についてはご注意ください。
- 8)MMCを挿入すると、MMCのNo.7の接触部にソケットのNo.7、8の信号コンタクトがショートする可能性があります。

■ 筐体の設計において

- 1)埃などの接触部への侵入は接触不良の原因になりますので、カバーを設けるなど筐体の設計にご配慮願います。
- 2)カードの挿抜をスムーズにするため、ソケット上面の金属シェルに力が加わらないよう筐体の設計にご配慮願います。金属シェルを押し付けるような力が加わった場合、カードが押えられ、イジェクトされない場合があります。
- 3)カード挿抜する際に過大な力が、ソケット本体に加わらないように、ガイドなどにより保持を行ってください。

■ カードの飛び出しにおいて

- 1)本ソケットは決められた条件下でカード飛び出し防止機能を有しておりますが、誤った使用による事故を未然に防ぐためにも使用者に注意を促すことは、製造物責任の観点から強くお薦めいたします。
- 2)本ソケットの機構上、(1)カードの不完全な挿入状態、(2)カードの逆挿入状態、(3)カードの逆挿入後の飛び出し防止寿命を保証するものではありません。
- 3)本ソケットはカード飛び出しを防止するために、挿抜時にあえてカードに抵抗を加えています。そのため、通常カード挿入時、引き抜き時に抵抗を感じますが、ご了承ください。

■ その他

はんだ付け後P/C板の絶縁劣化を防止するためにコーティングする際には、ソケットにコーティング剤が付着しない方法で行ってください。